

## Auftragsarten:

<b>10</b>	=	<b>1-</b> seitige Leiterplatte, <b>o</b> hne bohren
<b>1M</b>	=	<b>1-</b> seitige Leiterplatte, <b>m</b> anuelles bohren
<b>1A</b>	=	<b>1-</b> seitige Leiterplatte, <b>a</b> utomatisch bohren
<b>20</b>	=	<b>2-</b> seitige Leiterplatte, <b>o</b> hne Bohren
<b>2M</b>	=	<b>2-</b> seitige Leiterplatte, <b>m</b> anuelles bohren
<b>2A</b>	=	<b>2-</b> seitige Leiterplatte, <b>a</b> utomatisches bohren

## Arbeitsschritte EINSEITIG:

### **10 + 1M:**

- 1) Basismaterial EINSEITIG um max. 5mm umlaufend größer (als die Platine) zuschneiden
- 2) Basismaterial in den Belichter legen
- 3) Filmvorlage so auf die Platine legen, sodass die Schrift LESERICHTIG positioniert wird (Film nicht festkleben) und belichten
- 4) Platine entwickeln (auf die Lesbarkeit der Schrift achten)
- 5) Platine ätzen usw....

### **1A:**

- 1) Basismaterial EINSEITIG um 5mm umlaufend größer (als die Platine ist) zuschneiden
- 2) Platine mit IS700 automatisch bohren (**alle Bohrungen**)
- 3) Film über Leuchtpult auf gebohrter Platine positionieren (ACHTUNG: Lochbild muss mit Pads überein stimmen und die Schrift im Layout muss nun lesbar sein) und mit Uhu-Stick die Folie nun auf einer Langseite (außerhalb der Platine) festkleben und belichten
- 4) Platine entwickeln (auf die Lesbarkeit der Schrift achten)
- 5) Platine ätzen usw....

## Arbeitsschritte DOPPELSEITIG:

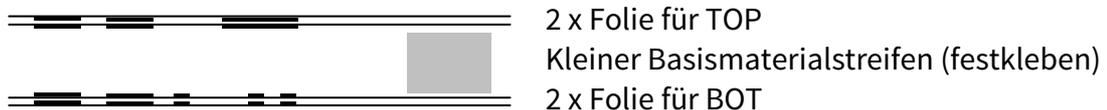
### 20 + 2M:

- 1) Basismaterial DOPPELSEITIG um max. 5mm umlaufend größer (als die Platine) zuschneiden
- 2) Filmtasche kleben (auf Lesbarkeit der Schrift achten)
- 3) Platine in die Filmtasche legen und beidseitig belichten

### 2A:

- 1) Basismaterial DOPPELSEITIG um 5mm umlaufend größer (als die Platine) zuschneiden
- 2) Platine mit IS700 automatisch bohren (**nur den ersten Bohrdurchmesser = Passmarkenbohrungen**)
- 3) Film über Leuchtpult auf gebohrter Platine positionieren und optimal auf Bohrungen einpassen (ACHTUNG: die Schrift im Layout muss nun lesbar sein). Mit Uhu-Stick die Folie nun auf einer Langseite (außerhalb der Platine) festkleben
- 4) Platine im doppelseitigem Belichter belichten
- 5) Platine entwickeln (Schrift auf Lesbarkeit überprüfen)
- 6) Platine ätzen
- 7) Schutzlack stripfen (10min)
- 8) Alle weiteren Bohrdurchmesser auf der IS700 bohren
- 9) Endzuschnitt
- 10) Oberfläche abschleifen
- 11) Lötack SK10 aufbringen (15min trocknen lassen)

### Filmtasche:



### Platine mit Filmtasche belichten:

